

FOR IMMEDIATE RELEASE

For more information, please contact:

Dean Solov

Cadence Design Systems, Inc.

408-944-7226

dsolov@cadence.com

CADENCE 가 TSMC EDA Partner Award, 3D-IC Technology 부문을 획득하다

CADENCE 가 Cadence 3D-IC 제품을 이용한 Silicon Interposer TSV Test Vehicle 분야에서 TSMC 와 합작

2011 년 11 월 14 일 캘리포니아, San Jose – 글로벌 일렉트로닉 디자인 혁신의 리더인 Cadence Design Systems, Inc. (NASDAQ: CDNS)가 오늘 발표한 내용에 따르면 TSMC 가 CADENCE 를 3D-IC Technology 에 대한 TSMC EDA Partner Award 수상자로 결정했다고 한다. 이 상은 일렉트로닉산업이 ultra portable 장비의 새로운 시대로 향해가는데 있어서 성능 향상과 더불어 전력소비와 크기, 무게를 줄이는 IC packaging 부문을 발전시키게 될 이 신생 테크놀로지에 대한 CADENCE 의 R&D 투자를 인정한 것이다.

CADENCE 는 TSV 를 통한 Cadence standard 3D-IC solutions 을 이용한 interposer test vehicle 을 제공하게 될 거라고 한다. 프로젝트는 system-on-chip (SoC) 과 eDRAM 을 silicon interposer 로 통합하는 내용을 포함하고 있다.

CADENCE Silicon Realization Group 의 연구개발 부문 Senior vice president, Chi-Ping Hsu 박사의 말이다. “IC 분야의 수많은 프로젝트를 통한 긴밀한 협력으로 TSMC 와 CADENCE 는 3D-IC 분야를 주도해왔다.” “현재의 chip 디자인이 성능과 파워, form factor 의 목표를 함께 달성하며 요구수준에 맞추기 위해서는 경쟁력 유지를 위한 새로운 접근이 필요하고 3D-IC 는 이에 대한 해결책을 제시할 수 있는 업계의 중요한 추세가 되고 있다. 우리는 TSMC 의 인정에 감사의 뜻을 표하며 반도체 산업에서의 이 중요하고 새로운 테크놀로지의 도입을 기대하고 있다.”

TSMC 의 design infrastructure marketing 부서 director 인 Suk Lee 의 말이다. “CADENCE 의 3D-IC 분야에 대한 공헌을 인정할 수 있게 된 점을 기쁘게 생각한다.” “이 새로운 테크놀로지를 통해 처리능력과 성능이 계속해서 발달할 수 있을 것이다.”

About CADENCE

CADENCE는 글로벌 일렉트로닉 디자인을 혁신하고 현재의 integrated circuits and electronics 개발하는 일에 중요한 역할을 하고 있다. 고객은 CADENCE의 software와 hardware, IP 및 서비스를 이용해 수준 높은 반도체와 가전제품, 네트워킹, 텔레커뮤니케이션, 컴퓨터 시스템을 디자인하고 검증한다. 캘리포니아, San Jose에 본사가 위치해있으며 세계 각지에 있는 영업본부와 디자인 센터, 연구시설과 함께 글로벌 일렉트로닉 산업을 지원한다. 회사와 제품, 서비스에 대한 더 많은 정보는 www.cadence.com에서 확인할 수 있다.